

# Renesas RZ/G2専用 IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E) Bluetooth® v5.2対応 無線LANコンボモジュール SX-PCEAX-R



Wi-Fi 6テクノロジー搭載の無線LANデバイス開発に最適な無線LANソリューション

## 概要

本製品は、無線LANの新規格であるIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E)と Bluetooth® v5.2に対応したトライバンド無線LANコンボモジュールです。Qualcomm社製 WCN6856チップセットを搭載している本製品は、MU-MIMOやOFDMAなどWi-Fi 6ならではの機能に対応しています。また、Renesas社製RZ/G2シリーズ専用のドライバポータリングガイドにより、専門的な知識を必要とするドライバの組込開発をサポート致します。

## 特長

- 2.4GHz帯、5GHz帯の他、6GHz帯にも対応
- PHYデータレート 最大2.4Gbps(11ax HE160時)
- 160MHz帯域モード対応(5GHz/6GHz)
- 高密度の変調モードに対応(1.024QAM)
- Bluetooth® v5.2対応
- 多様なニーズを満たすマルチ形状
  - M.2 2230タイプ
  - Half Mini Cardタイプ
- 無線規格対応
  - 日本、アメリカ、カナダ、欧州、イギリス

## 対応プラットフォーム※1

- Renesas RZ/G2E

## 対応ドライバ

- OS
  - Linux Kernel 4.19.198
- 無線LAN : ath11k
  - Station機能
  - WPA™/WPA2™/WPA3™認証
  - IEEE 802.1X (TLS, TTLS, PEAP)
- Bluetooth : BlueZ
  - 動作確認プロファイル
    - ・ GATT
    - ・ SPP
- ドライバソースコードの入手方法
  - オープンソースコミュニティサイトから入手
  - ドライバポータリングガイドおよび専用パッチファイルは準備中です

## 評価用環境

- Renesas社 RZ/G2E Reference Board EK874※2
  - Processor : RZ/G2E
  - PCIE x 1※3

## 製品仕様

型番	SX-PCEAX-R-M2	SX-PCEAX-R-HMC
チップセット	Qualcomm WCN6856	
ホストインタフェース	無線LAN : PCI Express 3.0 Bluetooth® : USB 1.1	
無線規格	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2x2)	
Bluetooth®規格	Bluetooth® v5.2 (BR/EDR/LE class1準拠)	
アンテナ端子	MHF4コネクタ : 2個	
動作電圧	3.3V	
消費電流 (無線LAN)	[2.4GHz] 送信:860 mA、受信:270mA [5GHz] 送信:1,110mA、受信:350mA [6GHz] 送信:1,150mA、受信:350mA	
消費電流 (Bluetooth®)	送信 : 130mA、受信 : 50mA	
動作環境条件	温度条件 : -20 ~ 65℃ 湿度条件 : 5 ~ 85%RH (結露なきこと)	
保存環境条件	温度条件 : -40 ~ 85℃ 湿度条件 : 5 ~ 60%RH (結露なきこと)	
外形寸法	22.00×30.00×2.70mm	29.85×26.65×2.90mm
重量	2.4g	3.1g
パッケージタイプ	M.2 Card type 2230-S3-E	Half Mini PCI Express Card
無線規格対応	日本、アメリカ、カナダ、欧州、イギリス	

- ※1 対応プラットフォーム以外でのモジュール利用に対しては、品質保証の対象外となりますのでご注意ください。Renesas社 RZ/G2Eについては、Renesas社のホームページをご確認ください。
- ※2 Renesas社 RZ/G2E Reference Board EK874については、Renesas社のホームページをご確認ください。
- ※3 本評価用環境をご使用の際には、別途、PCIE to M2、あるいは PCIE to PCIe Half Mini Card 変換ボードが必要です。

## [SX-PCEAX-R 製品紹介ページ]

<https://www.silex.jp/products/wireless-module/sxpceaxr.html>

● Qualcommは、米国 Qualcomm Technologies, Inc. の米国及び他の国における登録商標または商標です。  
● その他記載された社名及び製品名は各社の登録商標または商標です。

● Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, Inc. の商標または登録商標です。  
● 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。記載の仕様は2022年10月現在のものです。